

组织新昇集成电路用 300mm 硅片产能升级太原项目 IT 技术基础规划和实施建设
工程中标结果公示

(招标编号: Z31010006BM000079001001)

一、中标人信息:

标段(包)[001]新昇集成电路用 300mm 硅片产能升级太原项目 IT 技术基础规划和实施建设工程:

中标人: 上海鑫融网络科技股份有限公司 中标价格: 1183.853428 万元

二、其他:

1. 项目名称: 组织新昇集成电路用 300mm 硅片产能升级太原项目 IT 技术基础规划和实施建设工程
2. 中标人: 上海鑫融网络科技股份有限公司
3. 中标金额: 1183.853428 万元
4. 中标日期: 2024 年 03 月 18 日
5. 中标内容: 本次 IT 基础设施招标建设范围主要包括切磨抛车间、拉晶车间以及 OA 办公楼等区域的 IT 技术基础规划以及实施, 其中施工具体范围为拉晶车间(共三层)、切磨抛车间(共三层)、丙类仓库(共三层)、研发楼(五层), FAB 车间的基础 IT 技术实施需要结合车间生产机台就位的不同时间节点进行安排施工。
6. 定标原因及依据: 招标人确定排名第一的中标候选人为中标人

三、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

四、联系方式

招标人: 上海新昇半导体科技有限公司
地址: 上海浦东新区泥城镇云水路 1000 号
联系人: 牛景亚
电话: 021-51855700
电子邮件: /

招标代理机构: 上海继彰工程造价咨询有限公司

地 址： [上海市普陀区真南路 1228 号 1 号楼 1605 室](#)

联 系 人： [孙文斌](#)

电 话： [13817999102](#)

电子邮件： 372984665@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： _____（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）